

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成26年12月18日 (2014.12.18)

【公開番号】特開2013-258175(P2013-258175A)

【公開日】平成25年12月26日 (2013.12.26)

【年通号数】公開・登録公報2013-069

【出願番号】特願2012-131691(P2012-131691)

【国際特許分類】

H 0 1 L 33/60 (2010.01)

【F I】

H 0 1 L 33/00 4 3 2

【手続補正書】

【提出日】平成26年10月30日 (2014.10.30)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

回路基板上に L E D ダイを実装し、該 L E D ダイを透光性の封止部材で被覆した半導体発光装置において、

前記封止部材は上部に溝を備え、

該溝は前記封止部材の上部全体に亘り、中心部が最も低く、白色部材が充填され、

前記溝と直交する前記封止部材の一对の側面に白色部材を備えている

ことを特徴とする半導体発光装置。

【請求項 2】

前記溝が V 溝であることを特徴とする請求項 1 に記載の半導体発光装置。

【請求項 3】

前記 L E D ダイがフリップチップ実装されていることを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載の半導体発光装置。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 0 7

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 0 7】

上記課題を解決するため本発明の半導体発光装置は、回路基板上に L E D ダイを実装し、該 L E D ダイを透光性の封止部材で被覆した半導体発光装置において、

前記封止部材は上部に溝を備え、

該溝は前記封止部材の上部全体に亘り、中心部が最も低く、白色部材が充填され、

前記溝と直交する前記封止部材の一对の側面に白色部材を備えている

ことを特徴とする。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 0 9

【補正方法】削除

【補正の内容】